

2-3-1-6 SR 装置傷／SR 接触装置の伤痕／Scratch on solder resist of the equipment

【特徴】SR に非常に長い直線または大きな半径の傷が見られる状態の欠陥、平行な複数傷が見られることもある

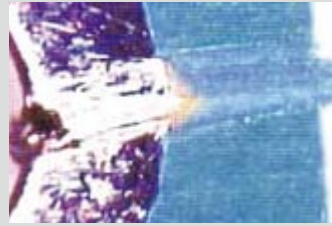
【特徴】在 SR 上可见非常长的直线以及大半径伤痕的缺陷，有时也可见平行的多处伤痕。

【Characteristics】A scratch of a very long straight line or an arc with a large radius is present on the solder resist surface. Sometimes more than one scratch runs in parallel.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 表面に製造装置の一部が連続的に触れて出来たもの（SR 塗布乾燥後のコンベア搬送工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 表面连续地接触制造装置的局部所引起的（SR 烘干后的传送工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by continuous contact of a part of the manufacturing equipment with the solder resist surface. (Conveyor transportation after solder resist application)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

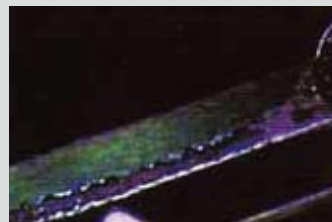
【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

2-3-1-7 SR 部分的むら／SR 的局部颜色不均匀／Partially uneven solder resist

【特徴】SR に広い面積の色むらが見られる状態の欠陥

【特徴】在 SR 上可见大面积的颜色不均匀的缺陷。

【Characteristics】The colour of solder resist looks uneven over a large area.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR のはじきや塗布むらなどのSR 厚さむらにより出来たもの、（SR 乾燥工程）

【原因、判断要点、发生工序】由于SR 的凹陷或者涂布不均匀等导致厚度不一致所引起的（SR 烘干工序）。



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×